

第 56 回 電子デバイス実装研究委員会

日時：2026 年 5 月 19 日（火） 13:00～16:00

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 飯岡 諒（Western Digital Tehchnologies GK）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:40 Mate+研究発表賞受賞記念講演

『焼結型 Cu ペーストの実用化に向けたプロセスの検討』（30 分）

.....○米野 斐、櫻井 晶、山口 朋彦（三菱マテリアル(株)）

13:40～14:10 Mate+研究発表賞受賞記念講演

『鉛フリーはんだ接合部の疲労寿命評価の試験サイクル数短縮に関する検討』（30 分）

.....○中村 郁仁、安部 元（三菱電機(株)）

14:10～14:40 Mate+研究発表賞受賞記念講演

『インサート金属を用いた SiC 基材の接合技術と TEM による界面解析』（30 分）

.....○尾崎 友厚、津田 大、森 茂生（大阪産業技術研究所）

14:40～14:50 休憩

司会 立花 芳恵（千住金属工業(株)）

14:50～15:20 Mate+研究発表賞受賞記念講演

『銀ボンディングワイヤのパワーデバイス実装への適用可能性とパワーサイクル特性評価』（30 分）

.....○武田 英幸、三苫 修一、市川 司、松永 紫津、山下 勉（田中電子工業(株)）

15:20～16:00

『無電解 Ni-P めっきのナノ組織制御による高耐熱化メカニズム』（40 分）

.....○三ツ井 恒平、渡邊 裕彦、齋藤 俊介、橋爪 佳、藤本 亮祐（富士電機(株)）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。
※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。
一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会